

2024年度実施方針

半導体・情報インフラ部

1. 件名：(大項目) 特定半導体利子補給事業

2. 根拠法

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第15条第14号

3. 背景・目的

半導体は、デジタル化の進展により、自動車や医療機器等の様々な分野での活用が拡大する一方、地政学的な事情から、グローバルなサプライチェーンが影響を受けるリスクが高まっている。あらゆる産業に影響を与え、5Gシステムに不可欠な先端半導体の安定供給を確保することが、産業基盤の強靱化や戦略的自律性・不可欠性の向上の観点で、最重要課題となっている。

本事業では、先端半導体の国内生産拠点における継続生産等を進めることで、国内での先端半導体の安定供給に貢献する。

4. 事業内容

4.1 事業概要

特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律（以下「5G促進法」という。）第29条第2号の規定及び特定半導体利子補給金交付規程に基づき、経済産業大臣が認定した認定特定半導体生産施設整備等計画に従って実施される特定半導体生産施設整備等（特定半導体生産施設における生産関係に限る。）を行うため認定特定半導体生産施設整備等事業者に対して必要な資金の貸付けを行う融資計画及び当該計画に係る融資を行う金融機関について経済産業省が利子補給金の交付の方針の決定をした場合に、当該融資に係る利子補給金の支給の業務を行うとともに5G促進法第29条第3号に基づく附帯業務（同条第2号の業務に附帯する業務に限る。）を実施する。

4.2 事業の実施方針

<利子補給要件>

(1) 対象事業者

経済産業省が別途定める申請資格を有し、経済産業省が交付の方針の決定をした融資計画書に係る融資を行う金融機関

(2) 対象事業

経済産業省が別途定める融資の要件のうち、対象事業に係る規定の内容に適合し、経済産業省が交付の方針の決定をした融資計画書に係る交付対象融資

(3) 審査項目

融資計画書に対する経済産業省による交付の方針の決定に適合する範囲内であること。

<利子補給条件>

(1) 利子補給事業の実施期間

経済産業省が別途定める融資の要件のうち、実施期間に係る規定の範囲内であり、経済産業省が交付の方針の決定をした融資計画書に係る交付対象融資の期間

(2) 利子補給事業の規模・利子補給率

経済産業省が別途定める融資の要件のうち、利子補給の規模及び利子補給率に係る規定の内容の範囲内であり、経済産業省が決定をした交付の方針に適合する範囲内のもの

<本年度予算規模>

一般勘定 30 百万円（管理費含む。）

予算規模については、変動があり得る。

4. 3 これまでの事業実施状況

<実績額及び実施件数の推移>

	2022 年度	2023 年度
実績額（交付決定額）	0 円	0 円
実施件数（交付決定件数）	0 件	0 件

5. 事業の実施方式

実施スキーム（別紙参照）

6. その他重要事項

評価の方法

外部有識者により構成される委員会において、審査業務が適切に実行されているかを評価する。

7. 複数年度交付決定の実施

申請者の申請に応じ、単年度又は複数年度交付決定を行う。

8. スケジュール

本年度スケジュール

2024年

4月 : 交付申請受付開始(随時)

9. 実施方針の改定履歴

(1) 2024年3月 制定

(2) 2024年7月 組織改編による改定

(別紙)

